

2026 第1期
总第91期

电接插元件信息简报



中国电子元件行业协会
电接插元件分会

目 录

电接插元件信息简报

主办 中国电子元件行业协会
电接插元件分会

双月刊

2026 年 第 1 期
总 第 91 期

编辑发行 分会秘书处
发送范围 内部赠阅

电子版可登录分会网站下载

外网投稿
connector@ic-ceca.org.cn

分会秘书处
地址 河南省洛阳市涧西区
浅井南路与丽春西路交叉口

邮编 471003
电话 0379-63011334

E-mail
connector@ic-ceca.org.cn

网址
connector.ic-ceca.org.cn

政策导向

习近平总书记指引未来产业发展	P02
工信部新修《技术合同认定登记管理办法》解读	P04
工信部等五部门部署加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展	P05
工信部等五部门联合印发《科技服务业标准体系建设指南（2025 版）》	P05

市场动态

2025 年我国规上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%	P06
2026 年连接器行业发展趋势预测：技术迭代与需求扩容双轮驱动	P07
原材料价格飙升，铜材年消耗 61 万吨！连接器大厂接连涨价	P08
央视聚焦博威合金“铝代铜”：新能源汽车材料加速走向规模化	P09
人形机器人规模化元年已至，中国厂商抢占先发优势	P10

新品速递

中航光电推出 UQD 及 UQDB 系列液冷快速接头	P11
硕泰推出 800 引脚高性能阵列连接器	P11
安费诺推出 Cool Express Link	P12
隆堡推出 25 系列 IPx7 防护等级新型 RJ45 模块化穿墙馈通件	P12
TE Connectivity 推出全新 SOLARLOK PVA1 光伏连接器	P13
I-PEX 推出 CABLINE®-UM 70pin 同轴线连接器	P14
JAE 推出支持千兆以太网的“MX74 系列”汽车用连接器	P14

技术资讯

莫仕发布 2026 年十大预测	P15
铝代铜：电气工程中的成本优化与轻量化革新之路	P16

企业动态

安费诺 231 亿美元收官全年	P18
莫仕 12 亿增资东莞，聚焦 AI 服务器高速连接	P18
瑞可达“机器人+全球化”双轮驱动	P19
富士达近期主导发布两项 IEC 国际标准，累计已达 18 项	P19
立讯精密在昆山成立新科技公司，入局无人机市场	P19
维峰电子实验室通过 CNAS 国家认可	P20
泰科与汇川技术签署战略合作协议	P20
中兴通讯发布《超节点技术白皮书》	P20

专利信息

国家知识产权局专利公开公告情况（2025 年 1-12 月、2026 年 1 月）	P21
---	-----

协会公告

分会 2026 年 1 季度重点发布讯息	P22
分会组织的多项团体标准会议在武汉顺利召开	P22
GB/T 1.1、GB/T 20001.10 标准专题培训顺利完成	P23
2026 年中国电子元件行业协会秘书长联席会议在哈尔滨召开	P23
中国电子元件行业协会收到工业和信息化部运行监测协调局的感谢信	P24
关于持续向广大会员单位征集稿件的事宜	P24



习近平总书记指引未来产业发展

2月9日上午，习近平总书记来到位于北京亦庄的国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况。

信创是保障信息技术安全的基础，也为“落子”未来，推动量子科技、脑机接口等领域发展持续夯实着底层技术支撑。

1月30日，中共中央政治局进行第二十四次集体学习，聚焦的主题正是前瞻布局和发展未来产业。

新一轮科技革命和产业变革加速演进，作为新质生产力的重要载体，发展未来产业是应对全球产业竞争的主动选择，塑造长远发展新优势的关键支点。

“十五五”开局之年的首次地方考察、首次集体学习，释放加快实现高水平科技自立自强的鲜明信号，凸显当前以重大科技创新推动未来产业发展，谋定在先、赢得主动的战略性、紧迫性。

（一）擘画全局，抢占未来制高点

在决定未来走向的关键时点，未来产业的战略意义提升到新的高度。

今年中央政治局首次集体学习中，习近平总书记强调，要站在推进强国建设、民族复兴伟业的高度，立足客观条件，发挥比较优势，坚持稳中求进、梯度培育，推动我国未来产业发展不断取得新突破。

在北京考察期间，习近平总书记来到亦庄这个新兴产业、未来产业发展的“热土”，再次把目光投向科技创新和产业创新，察看代表性科技创新成果展示，叮嘱“要充分发挥我们国家集中力量办大事的优势，把各种优质要素集合起来攻关”。

未来产业由前沿技术驱动，具有前瞻性、战略性、颠覆性等特点。

“对于抢占科技和产业制高点、把握发展主动权，对于发展新质生产力、建设现代化产业体系，对于提高人民生活品质、促进人的全面发展和社会全面进步，都具有重要意义”。习近平总书记从三方面深刻阐明培育发展未来产业的战略必然。

高度重视，是“把准了时代脉搏”，也是对“历史性交汇期”的深入研判——

每一轮科技革命和产业变革都会催生全新的主导型未来产业，从机械化、电气化、自动化到信息化，重大科技革命带动产业革命，国与国的力量对比一次次被改写。

我国处在基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，面对复杂的外部环境和激烈的大国博弈，人工智能、量子科技等一批前沿技术迈入爆发的关键节点。发展未来产业既是大变局的重要组成部分，也是影响大变局走向的关键力量，已从长远布局的“选项”变为当下必争的“刚需”。

2013年9月，十八届中共中央政治局集体学习将“课堂”搬到中关村。习近平总书记深刻指出：“即将出现的新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，为我们实施创新驱动发展战略提供了难得的重大机遇。机会稍纵即逝，抓住了就是机遇，抓不住就是挑战。”

2014年6月，两院院士大会上，提到“有的人工智能机器人已具有相当程度的自主思维和学习能力”，总书记特别强调“这样的新技术新领域还很多，我们要审时度势、全盘考虑、抓紧谋划、扎实推进”。同年的中央经济工作会议部署了“探索未来产业发展方向”。

在黑龙江考察时提出加快形成新质生产力，要求“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业”；在安徽考察时来到合肥滨湖科学城，在智能网联汽车、新一代信息技术等高新科技产品前驻足，在听取安徽省委和省政府工作汇报时指出“超前布局未来产业”；此次在北京考察，来到国家信创园，走进展厅察看人工智能、机器人等科技创新成果展示……

从应变看求变，从战略看策略，习近平总书记深刻回答了为什么发展未来产业、发展什么样的未来产业等一系列重大问题，对下好“先手棋”作出前瞻性、战略性、全局性谋划。

“十三五”规划纲要提出在空天海洋、信息网络、

生命科学、核技术等领域，培育一批战略性新兴产业；“十四五”规划纲要部署组织实施未来产业孵化与加速计划；“十五五”规划建议明确前瞻布局未来产业，鲜明提出推动形成量子科技、生物制造、氢能和核聚变能等新的经济增长点……战略、规划相互衔接、压茬推进，得时无怠、只争朝夕。

站在今天回看，我国扭转通信技术落后的局面，实现 4G 并跑、5G 引领；“新三样”从名不见经传到发展成中国制造新的闪亮名片；在人工智能多个领域跻身世界前列……在一些领域迎头赶上甚至“弯道超车”，正是多年前“播种未来”结出的硕果。

立足发展趋势，我国已成为创新力上升最快的经济体之一，集中力量办大事的制度优势，超大规模市场、丰富应用场景、最完备工业体系等，都为发展未来产业提供了丰厚的基础。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在开启新的创新周期，一场关乎国运、着眼长远的产业布局全面展开。练就“杀手锏”、跑稳“接力赛”，要求我们做好重大科技任务的布局、做好战略产业发展的规划，这是时不我待的机遇，也是不容有失的考验。

（二）科技突围，筑牢向新硬支撑

未来产业是“从 0 到 1”的先发布局，注定了其发展的核心就是创新，特别是重大原创性、颠覆性创新。

习近平总书记深刻指出，科技突破的程度，很大程度上决定未来产业发展的速度、广度、深度。

当前，我国在一些关键核心技术方面仍存在“卡脖子”情况，再造中国高技术产业，引领未来发展的科技储备还需加强，要在科技自立自强上取得更大进展。

要做哪些创新？如何创新？

找准主攻方向，突出“战略性、前瞻性、体系化布局”——

未来产业的发展不是平均用力，要充分考虑技术影响力、市场潜力和战略属性，精准把握全球科技创新趋势。

对于正呈爆发之势的人工智能，习近平总书记曾以“头雁”为喻，用 4 个“战略”形容其至关重要：

“是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”“是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术”“是我们赢得全球科技竞争主动

权的重要战略抓手”“是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源”。

从指出区块链技术集成应用的重要作用，强调“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”，到点明量子科技发展的重大科学意义和战略价值，提出“加强量子科技发展战略谋划和系统布局”，一次次对未来产业创新作出精确标注。

去年 4 月赴上海、11 月赴广东，这次在北京，一年时间里，习近平总书记分别到上海（长三角）、粤港澳大湾区、北京（京津冀）三大国际科技创新中心考察，关于夯实关键核心技术攻关能力、加强原始创新策源地建设的指向十分清晰。

立足需求牵引，强化科技创新与产业创新深度融合——

坚持“产业出题、科技答题”，关键要实现创新链与产业链的“无缝对接”。

1 月 30 日的集体学习中，习近平总书记提出“要充分发挥新型举国体制优势”“加快科技成果转化应用”等要求，进一步明晰了推动两“链”深度融合的路径方向。

把科技落到产业发展上：我国已建设 2400 余个制造业中试平台，经过中试验证的科技成果，产业化成功率可达 80% 以上；启动第二阶段 6G 技术试验，开展未来产业重点细分赛道创新任务揭榜挂帅……一个个举措加快推动新技术“研”以致用。

让广阔市场推动产业向新：加快场景培育和开放，激荡市场需求与应用场景交融的“一池春水”；深入实施“人工智能+”行动，到 2027 年新一代智能终端、智能体等应用普及率将超 70%……充分发挥市场的机制与力量，“战略性技术”在与千行百业的相融互促中迭代升级。

搭建良好生态，更好激发企业创新活力——

“很多未来产业的兴起是靠企业一步步突破带动的。”对于未来产业的发展，习近平总书记强调要发挥企业主体作用。

目前，我国人工智能企业数量超过 6000 家。同时，大量企业积极投身于量子科技、生物制造等新赛道，为它们搭建起良好的市场环境和产业生态至关重要。

一方面，政府要做好服务，以政策支持推动各类

创新资源向企业集聚；另一方面，也要注重梯度培育，形成龙头企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”的格局，切实做到总书记所说的“大力培育核心技术领先、创新能力强的科技领军企业和高新技术企业，引领带动产业向前沿和高端领域迈进”。

（三）稳中求进，推动未来产业高质量发展

未来产业培育周期长、市场风险大，在培育的过程中，要把握好稳与进的关系，统筹好发展与安全。

从明确“立足客观条件，发挥比较优势”“坚持稳中求进、梯度培育”，到叮嘱“必须健全治理体系”，习近平总书记揭示未来产业发展应遵循的方法。

首先就是坚持从实际出发，“因地制宜、错位发展”的要求须臾不可放松。

眼下，国家层面聚焦重点领域，点明量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等方向。产业发展是一个多层次、多梯度的宏阔整体，各地竞速未来产业发展，要在区域层面根据资源禀赋、产业基础、科研条件等选择布局方向，发挥比较优势，探索发展路径。

以京津冀为例，“十四五”期间，北京流向津冀的技术合同成交额大幅增长，“北京研发、津冀转化”模式效应显著。创新型城市群是国际竞争新的平台，扩围北京（京津冀）国际科技创新中心建设，实现要素深度协同、成果高效转化，正是对未来产业路径的探索实践。

产业变迁是久久为功的过程，布局未来要以恒心求恒进。

谋划未来产业，习近平总书记明确要“稳中求进”：

2020 年 10 月，在十九届中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行的第二十四次集体学习中，指出“颠覆性技术的形成是个厚积薄发的过程”，要“坚定信心、埋头苦干，突破关键核心技术，努力在关键领域实现自主可控，保障产业链供应链安全”；

2023 年 7 月，在江苏南京紫金山实验室，详细了解推进重大科技任务攻关等情况，听到刘韵洁院士讲述“以十年磨一剑的坚持，初步攻克了一系列核心技术”时，对科研团队取得的进展给予充分肯定。习近平总书记强调“要走求实扎实的创新路子”。

这些都要求我们在产业向新的长跑中，构建起对

科研长周期的支持机制和宽容氛围，坚持“科学论证技术路线”，循序渐进地推进；沉下心来对不同产业“量身定制”规划和扶持政策；强化产业间的协同，推动未来产业同新兴产业、传统产业相得益彰。

与此同时，要按照习近平总书记提出的“探索科学有效的监管方式，防范相关风险，确保既‘放得活’又‘管得好’”，实现科技向善、确保行稳致远。

通往未来之路正在以前所未有的方式铺展。开局之年，起步之时，落实习近平总书记要求，“推动我国未来产业发展不断取得新突破”，让高质量发展的动力更加强劲，中国经济必将持续呈现勃勃生机。

（来源：新华社 /20260212）

工信部新修《技术合同认定登记管理办法》解读

2026 年 1 月 23 日，工业和信息化部正式印发新修订的《技术合同认定登记管理办法》（工信部科〔2026〕18 号，下称“新办法”），并将于 2026 年 3 月 1 日起全面施行。

这是继 2000 年原国家科委《技术合同认定登记管理办法》（国科发政字〔2000〕063 号）施行 26 年后的首次系统性重构，亦是技术合同登记管理职能随机机构改革由科技部变更为工信部后，首部以工信部名义发布的顶层制度文件。

作为科技成果转化“减免税+奖励提取”的政策入口，技术合同认定登记历来是企业享受增值税减免、所得税优惠、研发费用加计扣除及科研人员现金奖励个税减免的“法定凭证”。此次新办法绝非简单的条款修订，而是中国技术要素市场从“分散管理”走向“全国统一治理”的标志性转折。

现对新旧办法进行逐条比对，拆解新办法背后释放的三层战略信号。

第一层跃迁：从“科技管理”到“产业治理”——主管部门变更的深层逻辑

2000 年，技术合同登记由科技部主导，彼时的核心任务是“落实税收优惠、防止税源流失”；2026 年，管理职能随机机构改革转隶工信部，这不是简单的印章交接，而是国家创新体系逻辑的根本升级。

工信部主管工业、信息产业及中小企业，其政策

语言是“产业链、场景、应用、供应链”。新办法总则第一条明确写入“加快培育全国一体化技术市场”，这与国资委同期部署的“央企成果转化中试平台开放”“首台套首批次首版次采购”形成政策组合拳——技术要素不仅仅是科技系统的产出，更是工业体系的战略输入。

对于成果转化服务机构而言，意味着技术交易的场景化、产业化属性将被空前强化，单纯的“技术搬家”已无法满足政策要求，唯有深度嵌入产业链、精准匹配工业场景，才能真正抓住政策红利。

第二层跃迁：从“权力分散”到“权责匹配”——省级主体责任全面压实

旧版办法中，登记机构多为区县级科技部门，省级更多承担“指导”职能。新办法形成制度闭环，规定省级工信部门将成为技术合同登记的第一责任主体。过去部分地区“登记即过关”的宽松状态将彻底终结，大额合同专家审核机制、异议复核机制将实质性运转，合规门槛显著提升。

企业必须清醒认识到：技术合同登记不再是“走过场”，而是须经得起专家质询、复查审计的严肃行政行为。合同定性不准、技术交易额虚高、证明材料缺失，都将直接导致登记失败甚至税务风险。

第三层跃迁：从“行政确认”到“生态赋能”——技术经理人首次入法

新办法“鼓励省级主管部门加强技术转移机构和技术经理人队伍建设，发挥技术经理人在技术合同成交中的积极作用”。这是国家层级的部门规章首次明确“技术经理人”的法律地位。过去，技术经理人“有职业无名分、有贡献无职称”；如今，国家以技术合同登记为切口，将技术经理人正式纳入技术市场制度体系。可以预见：技术合同登记量、技术交易额将逐步与技术转移人才评价、职称评定挂钩，北上广深及苏浙皖已试点的“技术经纪专业职称”有望全国推开。

结语：制度升维，服务跟进

从 2000 年到 2024 年，中国技术合同成交总额从 650 亿元跃升至 6.8 万亿元，增长百倍。而这一次的制度迭代，将决定未来十年技术要素市场的底层运行逻辑。

（来源：内蒙古成果转化 /20260223）

工信部等五部门部署加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展

工业和信息化部、中央网信办、中央空管办、国家发展改革委、中国民航局等五部门近日联合印发《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》（以下简称《意见》）。

《意见》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“需求牵引，重点突出；集约复用，多元协同；试验先行，稳步推进；安全可控，筑牢屏障”的原则，持续提升信息通信业技术、产业、网络和安全等供给能力，为低空经济发展提供坚实基础。到 2027 年，全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于 90%，多元融合感知方案进一步完善成熟，低空导航服务水平持续提升，研制不少于 10 项信息类基础设施标准，面向城市治理、物流运输、文旅等领域形成一批典型低空应用场景。

《意见》围绕低空通信、监视、导航、智能网联系统等信息类基础设施，提出按需推进低空场景通信网络覆盖、探索构建多元探测协同服务能力、助力提升导航精准服务水平、支撑构建低空智能网联系统等 4 方面重点任务。围绕加强信息通信业能力建设，提出组织开展试验验证、提升产业供给能力、推动集约协同与标准化建设、规范行业管理、强化网络和数据安全保障、优化频率供给等 6 方面具体举措。从强化统筹联动、加大支持力度、加强跟踪评估等方面提出有关组织保障措施。

（来源：工信微报 /20260210）

工信部等五部门联合印发《科技服务业标准体系建设指南（2025 版）》

一、政策定位与战略背景

该文件是工信部、科技部、住建部、市场监管总局、知识产权局五部委联合印发的《科技服务业标准体系建设指南（2025 版）》（工信部联科〔2026〕15 号），是落实《工业和信息化部等九部门关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》的核心配套文件。科技服务业被定义为“运用现代科学知识和技术手段，围绕科技创新全链条发展、科技成果高效率转化，向社会提供智力服务的新兴产业”，涵盖研究开发、

技术转移转化、企业孵化、检验检测认证、科技金融、知识产权等十大细分领域。政策出台背景是我国科技服务业“新型服务主体不断涌现，服务业态不断丰富，新技术、新模式、新业态层出不穷”，但标准缺失已成为制约高质量发展的关键瓶颈，亟需通过系统化标准建设规范和引领行业从“野蛮生长”转向“精耕细作”。

二、“三层级+十领域”标准体系架构

指南构建“基础通用-重点领域-管理保障”三层级标准体系：

基础通用层包括术语定义、分类编码、基本准则，解决行业“话语体系不统一”问题；重点领域层覆盖研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广、检验检测认证、信息技术、工程技术、科技金融、知识产权、科技咨询十大领域，其中技术转移转化标准细化到科技成果价值评估、技术拍卖、技术作价入股、概念验证等具体操作环节，科技金融服务标准明确知识产权质押贷、科技成果转化保险、企业创新积分制、知识产权证券化等创新工具规范；管理保障层则聚焦机构管理、人员管理、服务管理、信息管理、数据统计，首次将技术经理人、创业导师、科技咨询师等从业人员的能力评价纳入国家标准体系。

三、量化目标与实施路径

政策设定“两步走”刚性目标：到 2027 年，新制定国家标准和行业标准 40 项以上，面向超过 1000

家企业开展贯标工作，初步构建标准体系；到 2030 年，新制定标准 80 项以上，基本建成满足高质量发展的标准体系。实施机制强调“统筹产学研用各方”，要求加强标准化技术组织协同，开展重点标准宣贯培训和实施推广，引导企业对标达标，并“深化国际合作”，推动科技服务机构深度参与国际标准化活动。这种设计将标准制定与产业应用紧密耦合，避免“为标准化而标准化”的形式主义，确保标准“有用、能用、好用”。

四、产业影响与战略价值

该政策是重塑科技创新生态的基础性制度安排。对科技服务机构而言，标准体系提供了业务规范、能力评价、市场准入的统一标尺，将加速行业洗牌，推动优质服务主体脱颖而出；对制造业企业而言，研究开发服务标准规范了从立项到验收的全流程，检验检测认证标准强化了质量基础设施支撑，降低技术创新风险；对区域经济而言，通过企业孵化服务标准和技术推广服务标准的落地，可提升孵化器、大学科技园、生产力促进中心的服务效能，加速科技成果转化和产业化。更深层的战略意图在于构建“科技-产业-金融”良性循环的标准底座——通过统一科技金融、知识产权、技术交易等关键环节的服务标准，降低制度性交易成本，为创新驱动发展提供可预期、可信赖、可复制的制度环境。

（来源：新华社 /20260212）

市场动态

2025 年我国规上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%

2025 年，我国电子信息制造业生产快速增长，出口同比持平，效益稳步向好，投资持续下滑，行业整体发展态势良好。

一、生产快速增长

2025 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 4.7 个和 1.2 个百分点。12 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 11.8%。主要产品中，手机产量

15.4 亿台，同比下降 5.8%，其中智能手机产量 12.7 亿台，同比下降 0.9%；微型计算机设备产量 3.32 亿台，同比下降 2.9%；集成电路产量 4843 亿块，同比增长 10.9%。

二、出口同比持平

2025 年，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比持平。12 月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长 1.2%。据海关统计，我国出口笔记本电脑 1.33 亿台，同比下降 7.1%；出口手机 7.51 亿台，同比下降 7.7%；出口集成电路 3495 亿个，

同比增长 17.4%。

三、效益稳步向好

2025 年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 17.4 万亿元，同比增长 7.4%；营业成本 15.1 万亿元，同比增长 6.9%；实现利润总额 7509 亿元，同比增长 19.5%；营业收入利润率为 4.3%，较 1—11 月提高 0.2 个百分点。

四、投资持续下滑

2025 年，电子信息制造业固定资产投资同比下降 3.8%，较 1—11 月下降 0.6 个百分点，比同期工业投资增速低 6.4 个百分点。

五、中部地区收入增长较快

2025 年，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入 122907 亿元，同比增长 7.8%，较 1—11 月回落 1 个百分点；中部地区实现营业收入 30149 亿元，同比增长 11.6%，较 1—11 月提高 1.5 个百分点；西部地区实现营业收入 20120 亿元，同比下降 0.3%，较 1—11 月提高 1.3 个百分点；东北地区实现营业收入 876.5 亿元，同比下降 3.3%，较 1—11 月回落 0.5 个百分点。12 月份，东部地区实现营业收入 12567 亿元，同比下降 0.4%；中部地区实现营业收入 3445 亿元，同比增长 24.3%；西部地区实现营业收入 2110 亿元，同比增长 11.9%；东北地区实现营业收入 93.7 亿元，同比下降 7.1%。

注：1. 文中统计数据除注明外，其余均为国家统计局数据或据此测算。

2. 文中“电子信息制造业”与国民经济行业分类中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”为同一口径。

（来源：工信部官网 /20260202）

2026 年连接器行业发展趋势预测：技术迭代与需求扩容双轮驱动

一、技术创新成为核心竞争力，多维度突破加速落地

2026 年，连接器行业将持续以技术创新为核心驱动力，在性能、形态与适配性上实现多维度突破。高速传输需求的爆发将推动连接器技术向更高带宽、更低延迟演进，尤其是在数据中心、5G 基站等核心场景，

支持 100Gbps 以上传输速率的连接器将成为市场主流，满足海量数据实时交互的需求。

小型化与集成化趋势将进一步深化。随着消费电子、可穿戴设备、汽车电子等产品向轻薄化发展，微型连接器、板对板连接器的需求将持续增长，其封装尺寸将进一步缩小，同时需兼顾高可靠性与抗干扰能力。此外，智能化技术的融合将成为新亮点，具备状态监测、故障预警功能的智能连接器将逐步应用于工业自动化、新能源汽车等领域，通过数据反馈优化设备运行效率。

环保与耐用性也将成为技术研发的重要方向。在全球“双碳”目标下，采用环保材料、低功耗设计的连接器将更受市场青睐，同时耐高低温、抗振动、防腐蚀的特性将成为工业、汽车等极端场景下的核心要求。

二、应用场景扩容，核心领域需求持续攀升

2026 年，连接器行业的需求增长将高度依赖下游核心应用领域的扩容与升级，其中新能源汽车、工业互联网、消费电子、通信技术四大板块将成为主要增长点。

新能源汽车领域仍是连接器需求的“主力军”。随着全球新能源汽车渗透率的持续提升，以及汽车智能化、电动化程度的加深，车载连接器的使用量大幅增加，涵盖电池管理系统、动力控制系统、自动驾驶传感器等多个环节。高压连接器、高速信号连接器将成为需求热点，预计 2026 年该领域连接器市场规模增速将保持在 20% 以上。

工业互联网的加速落地将打开工业级连接器的增长空间。工业 4.0 推动下，工厂自动化、智能制造对设备互联的要求不断提高，工业连接器需满足恶劣工况下的稳定连接，同时适配工业以太网、物联网等技术，支持设备间的高速数据传输与协同工作。此外，机器人、智能仓储等新兴工业场景的兴起，将进一步扩大工业连接器的应用范围。

消费电子领域需求呈现“量稳质升”的特点。智能手机、平板电脑等传统消费电子产品仍保持庞大的市场基数，对微型连接器的精度与可靠性要求持续提高；而 AR/VR 设备、智能穿戴设备等新兴产品的爆发式增长，将催生新型连接器的需求，如柔性连接器、无线连接器等，以适配产品的特殊形态与使用场景。

通信技术的迭代升级为连接器行业注入持续动力。5G 网络的全面普及与 6G 技术的预研推进，将带动基站建设、通信设备更新的需求，高频、高速连接器将成为通信领域的核心配套产品；同时，数据中心的规模化建设与升级，对服务器、存储设备等硬件的连接性能提出更高要求，推动数据中心连接器向高密度、低功耗方向发展。

三、市场格局重构，区域竞争与供应链优化并行

2026 年，全球连接器市场格局将呈现“区域分化与协同发展”并存的态势。亚洲地区仍是全球连接器市场的核心增长极，中国、韩国、日本等国家凭借完整的产业链配套、庞大的下游需求与持续的技术投入，将保持领先地位。其中，中国作为全球最大的连接器生产与消费国，本土企业在中低端市场的占有率将进一步提升，同时在高端市场的进口替代进程加速，逐步打破国际品牌的垄断。

北美与欧洲市场则聚焦于高端连接器领域，在航空航天、医疗设备、汽车高端制造等细分市场具备技术优势，国际龙头企业将通过技术研发与并购重组巩固市场地位。不过，受全球供应链调整、区域贸易政策等因素影响，欧美市场将更注重供应链的本地化与安全性，这为区域内连接器企业带来发展机遇。

供应链的优化与韧性提升将成为行业共识。近年来，全球供应链波动频繁，原材料价格上涨、物流受阻等问题对连接器企业的生产经营带来挑战。2026 年，连接器企业将进一步加强供应链管理，通过与原材料供应商建立长期合作、布局多元化生产基地、提升库存管理效率等方式，降低供应链风险。同时，产业链上下游的协同合作将加深，连接器企业与下游设备制造商、上游材料供应商的联合研发将更趋紧密，实现产品与需求的精准匹配。

四、挑战与机遇并存，行业发展迈向高质量阶段

2026 年，连接器行业在迎来发展机遇的同时，也将面临多重挑战。一方面，技术迭代速度加快，企业需持续投入大量研发资金以跟上行业发展步伐，这对中小规模企业的资金实力与研发能力提出更高要求；另一方面，全球市场竞争日趋激烈，价格战与技术战并存，企业需在成本控制与技术创新之间寻求平衡。此外，原材料价格波动、环保政策收紧等外部因素也

将对行业发展带来不确定性。

但总体来看，连接器行业的长期发展趋势向好。随着数字经济的深入发展，各行各业对设备互联、数据传输的需求持续增长，为连接器行业提供了广阔的市场空间。同时，国内企业在技术研发、产品质量等方面的能力不断提升，进口替代与全球化布局的步伐加快，将推动中国连接器行业向高质量、高附加值方向转型。

2026 年，连接器行业将在技术创新的引领下，伴随下游应用领域的扩容实现稳步增长，市场格局将持续优化，行业整体将迈向更加成熟、高效、多元的发展阶段。对于企业而言，把握技术趋势、聚焦核心需求、优化供应链布局，将是在市场竞争中抢占先机的关键。

（来源：线束世界 /20260120）

原材料价格飙升，铜材年消耗 61 万吨！ 连接器大厂接连涨价

2026 年初，全球连接器行业迎来新一轮价格调整潮。受原材料价格持续飙升、能源及人工成本上涨等多重因素影响，包括 TE（泰科电子）、Amphenol（安费诺）、HUMMEL（胡默尔）、中国星坤在内的多家头部企业相继发布调价通知。

连接器是电子设备中的“神经枢纽”，随着工业、新能源汽车、AI 算力中心等领域的增长，连接器的需求只增不减。

连接器核心原材料主要包括铜、金、银等金属以及 LCP（液晶聚合物）等特种工程塑料。其中，在中国连接器行业中，铜材在汽车连接器系统年消耗量就达 61 万吨。据行业数据，沪铜主力价格已突破每吨 80,000 元大关，业内预测，今年铜价的均价将达到 1.1 万美元 / 吨；与此同时，黄金、白银等贵金属价格同步上扬；而用于高频高速连接器的 LCP 材料价格同比上涨 28%。

由于原材料成本在连接器总成本中占比高达 60% - 80%，其中仅铜材一项就占 40% - 60%，成本压力直接传导至终端产品，原有定价体系难以为继。

就在近两个月，行业内多家连接器企业接连宣布涨价：早在 2025 年 11 月 Amphenol（安费诺）就宣布自 1 月 1 日起对全系列产品调价。

TE Connectivity（泰科电子）在 1 月 27 日宣布自 2026 年 1 月 27 日起，对全产品线、全区域实施价格上调，未公布具体幅度，但强调为应对“持续攀升的制造成本”。HUMMEL（胡默尔）1 月宣布自 2026 年 2 月 1 日起执行新价格体系，整体涨幅为 3%-8%。

其他厂商如 HRS（广濑电机）、WEIDMÜLLER（魏德米勒）、YAZAKI（矢崎）等也纷纷跟进，涨幅普遍在 4%-15% 之间。

本轮涨价涵盖几乎所有连接器品类，覆盖通用件到高端连接器等。其中，高压连接器广泛应用于新能源汽车，对耐压、散热、密封性要求极高；高速高频连接器用于 5G 基站、AI 服务器、数据中心，依赖 LCP 等高性能材料；板对板 / 线对板连接器是消费电子和工业控制领域的基础元件。

特别是在 AI 需求的带动下，高速背板连接器、光模块接口及液冷连接解决方案的需求激增，推动相关产品价格涨幅显著高于行业平均水平。这些高附加值连接器不仅要求极低的信号损耗和超高传输速率，还需在高密度、高功耗环境下保持长期可靠性，进一步加剧了对高端材料与精密制造工艺的依赖，成为本轮涨价中成本压力最突出的细分领域。

短期内，涨价将加剧中游制造商的利润压缩，尤其对议价能力弱的中小企业构成生存挑战。下游如新能源汽车、通信设备、工业自动化等领域或将面临成本转嫁或供应紧张。

长期来看，行业竞争逻辑正从“低价内卷”转向“价值竞争”。头部企业凭借技术壁垒、供应链整合能力和客户粘性，有望进一步巩固市场地位。

此外，技术创新成为破局关键。行业正加快新材料替代（如铜合金优化、镀层工艺改进）、模块化设计及智能化集成，以降低单位金属用量并提升产品附加值。

（来源：电子发烧友综合报道 /20260209）

央视聚焦博威合金“铝代铜”：新能源汽车材料加速走向规模化

铝代铜产品加速迈向规模化应用，铝市场需求迅猛增长。据央视数据，2025 年国内汽车市场用铝量达 537.78 万吨，较 2024 年激增 110.17 万吨，涨幅高达

25.76%。我国作为全球铝产销大国，下游领域不断拓展，铝产能增长滞后，供不应求局面推动铝价攀升。特别是新能源汽车等产业的爆发，持续扩大铝产品消费规模，拓展其应用场景。近日，央视财经频道《经济信息联播》播出的《“铝”创新高 供应受限 需求增长 多重因素助推铝价上涨》节目中，博威合金汽车用铝代铜材料获重点报道。

以下是重点内容摘要：

博威合金铝代铜项目营销总监王耀淇表示：“我们的用铝量特别的大。最近，我们研发并落地了全新的汽车高低压线束材料。我手上这条线就是汽车低压信号线，换成铝线之后，只需要（以前）一半的重量。目前，这个低压信号线的产能，我们已经规划了 5000 吨。到明年的话，我们已经布局了全新的产线，单线的年产能可以达到 15000 吨。”

“铝代铜材料”未来展望

在新能源汽车智能化浪潮下，连接器材料对于高导电性、高强度、高可靠性要求不断升级。铜价高企，铜合金资源紧张，使“铝代铜”从设想变为极具实践价值的选择。同时，针对传统铝材高温蠕变、电化学腐蚀等行业痛点，博威合金联合泰科电子等产业链上下游企业，凭借在材料研发、工程设计及系统集成等方面的专业优势，共同开发出汽车低压载流线束“铝代铜”复合材料。

该材料基于原子级设计理念，通过精确调控材料微观结构，在 180℃ 高温下的蠕变性能与纯铜相近，攻克了传统铝材高温蠕变、电化学腐蚀等行业痛点，为行业发展带来重大突破。材料具备显著的经济与环境效益，有望助力单车成本降低，同时实现年减碳约 85 万吨，为低压线束市场开拓出约 360-480 亿的市场空间。截至目前，该材料已通过多家汽车主机厂验证，预计 2026 年底实现量产上车。

政策扶持叠加市场需求，铝代铜正成为汽车轻量化、绿色化发展的关键方向。博威合金凭借技术优势、研发能力及产业协同能力，在新能源汽车材料供应链中占据关键地位。在新能源汽车行业对连接器材料要求日益提升的背景下，博威合金将继续推动铝代铜材料发展革新，为新能源汽车行业的可持续发展注入强大动力。

（来源：博威合金、央视财经 /20260207）

人形机器人规模化元年已至，中国厂商抢占先发优势

人形机器人是指在结构形态上采用人形或类人形设计的机器人系统，通常具备躯干、头部、双臂等关键人形结构，并在功能层面集成类人的感知、学习、决策与执行能力。其通过仿人化的身体构型，能够模拟人类动作与交互行为，在动态环境中执行多任务，并实现与人类或其他系统的自然交互。2025 年，全球人形机器人市场迎来规模化起点。IDC 数据显示，全年全球人形机器人出货量接近 1.8 万台，同比增长约 508%，销售额约 4.4 亿美元；同期，累计销售订单量预计超过 3.5 万台，为后续交付和市场持续放量奠定基础。

• 中国厂商引领市场规模化落地

从厂商格局来看，中国厂商凭借完善的制造体系、快速迭代能力与成本优势，在全球市场中占据主导地位：智元机器人、宇树科技出货约为 5 千台，位居行业头部，具备规模化交付能力、产品成熟度以及应用场景覆盖上具有领先优势。乐聚机器人、加速进化和松延动力出货 1 千台左右，专注重点场景的落地。银河通用、优必选、众擎机器人、星尘智能等厂商的出货 4 百台到 1 千台，以试点项目和定制化交付为主。星动纪元、魔法原子、北京人形机器人创新中心、星海图、墨甲智创、逐际动力等公司实现了百台以上的出货，处于商业化早期探索阶段。

相比之下，Apptronik、Figure AI、Agility Robotics 等国际厂商仍主要处于试点测试阶段，出货量约数十台。Tesla 的人形机器人尚用于内部测试，预计将于 2026 年正式启动规模化量产。整体来看，中国厂商已在当前阶段的人形机器人规模化落地中占据先发优势。

• 全尺寸双足人形机器人领跑市场销售

从产品形态来看，2025 年全球人形机器人市场以双足形态为主。数据显示，双足机器人（全尺寸与中小型）合计贡献 66.3% 的市场销售额，成为当前市场的主流形态。其中，全尺寸双足人形机器人贡献

41.6% 的销售额，为所有产品形态中最高，凭借更高的智能化水平和复杂环境适应能力，在导览导购、文娱商演及科研教育等场景中实现较快推广。该细分市场呈现明显头部集中，智元机器人在商业化进展上领先。中小型双足人形机器人以轻量化设计和相对较低的单价优势，主要应用于文娱商演和教育培训等对负载和通用性要求相对较低的场景，成为双足机器人市场的重要补充。

相比之下，轮式机器人以移动性和成本优势在数据采集、工业制造及仓储物流等场景发挥作用。

• 应用场景初步落地，商业模式加速演进

从应用场景分布来看，人形机器人市场当前呈现出集中度较高、逐步多元化的发展特征。2025 年，市场需求主要由文娱商演、教育科研和数据采集等场景驱动，这些场景强调展示效果、交互体验或技术验证，成为人形机器人商业化落地的核心动力。

随着核心技术持续成熟、系统稳定性提升及成本逐步下降，工业、物流及其他垂直行业应用的市场空间有望进一步打开。

在商业模式方面，行业正由一次性硬件销售，逐步向 RaaS（Robot as a Service）、运维服务、平台化生态演进，探索“产品 + 服务 + 生态”并行的发展路径，为后续规模化应用和持续收入创造条件。

• 人形机器人加速工程化，智能协作能力成为下一步核心突破

作为具身智能机器人的高阶形态，人形机器人在多环境和多任务条件下具备高度灵活性与通用性。产业正由实验室验证向工程化、规模化应用过渡，本体、小脑（运动控制）与大脑（认知决策）协同发展，形成完整的技术架构。上肢精细操作作为关键突破，下肢在通用性与效率间寻求平衡；模块化与轻量化设计提升系统稳定性与部署灵活性。端到端“大小脑融合”大模型通过多模态感知、任务理解与动作执行闭环，实现从预编程执行向自主作业和人机协同的演进。

（来源：中国电子元件行业协会 / IDC 咨询 / 20260211）

新品速递

中航光电推出 UQD 及 UQDB 系列液冷快速接头

液冷技术的规模化落地，离不开核心连接件的创新突破与标准化支撑。随着 UQD 及 UQDB 系列液冷快速接头在数据中心服务器中的广泛应用和技术演进，越来越多的数据中心开始采用模块化、集成化的盲插液冷服务器架构，适配浮动模块的 UQD+UQDB 混合对插的用法受到了广大服务器厂家的青睐。

作为行业标准的积极推动者，中航光电全程深度参与 OCP UQD V1.0 与 V2.0 的标准编制工作，是国内唯一入选两个版本标准贡献厂家名单的企业。基于标准规范的核心要求，中航光电推出 UQD 及 UQDB 系列液冷快速接头，为液冷技术的标准化落地保驾护航。



UQD系列液冷快速接头



UQDB系列液冷快速接头

两款产品均为数据中心液冷系统的液冷快速接头，适配 AI 服务器、超级计算机等高功耗设备，通过连接冷板、机架与液冷管路，保障冷却液的安全流通与快速切换。

UQD 系列液冷快速接头，主要用于数据中心服务器与分水器、分水器与管道系统间的连接，可实现快速锁紧与分离；UQDB 系列盲插式液冷快速接头，则适用于模块板卡与机箱的快速对接，具备易安装、易维护的特点。

产品亮点：

1. 高性能密封防护：产品均采用高可靠密封设计，插合、断开状态下均可实现可靠密封，无介质泄漏，安全性与稳定性突出，其中 UQDB 系列具备平面无滴漏密封特性，杜绝介质浪费与污染。

2. 高耐久稳定品质：壳体均经特殊工艺处理，耐磨性与抗腐蚀性优异，可满足 5000 次机械插拔寿命，充分保障设备长期稳定运行。

3. 多规格灵活适配：配备四种通径规格，可精准匹配不同工作流量的应用需求，覆盖多元化使用场景。

4. 多维度配套防护：配套开发多自由度（轴向 + 径向 + 角度）浮动模组及防喷溅保护盒，全方位规避运行风险，为 UQD/UQDB 系列液冷快速接头长期可靠运行保驾护航。

5. UQD 系列专属亮点：搭载直推式锁紧结构，支持单手快速完成锁紧与分离操作，大幅提升作业效率；采用红、蓝双色标识清晰区分进水口与回水口，直观辨别，避免误接风险。

6. UQDB 系列专属亮点：采用无锁紧结构设计，依托外部配套结构实现稳固锁紧，适配特定安装场景需求；具备径向 $\pm 1\text{mm}$ 浮动能力，有效提升安装适配性与容错率，降低装配难度。

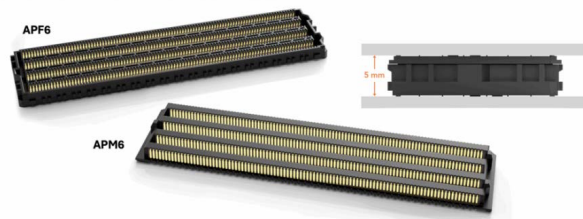
未来，中航光电将始终以技术创新为核心驱动力，迭代升级产品性能，拓展产品在超高功耗、超大规模算力场景的适配能力。同时，持续推动液冷快速接头的标准化、模块化升级，赋能数据中心与智算中心实现更高效率、更低能耗的绿色算力部署。

（来源：隆堡 / 20260203）

矽泰推出 800 引脚高性能阵列连接器

Samtec 推出 AcceleRate HP® 高性能阵列产品系列的新成员：堆叠高度为 5mm 的 800 引脚 APM6、APF6 连接器。

ACCELERATE^{HP}



AcceleRate HP® 连接器组具备卓越的信号完整性性能和密度：112 Gbps PAM4 速率，0.635mm 间距。这是各类需在狭小空间内实现极高数据吞吐量系统的

理想解决方案，适用于高性能计算（HPC）、人工智能（AI）、存储及网络等领域。

该系列连接器的数据速率兼容 PCIe® 6.0、CXL® 3.2 及 100 GbE 协议。Samtec 连接器的协议支持能力，通过对比协议通道数据速率与对应产品的 Samtec 通道性能指标计算得出。

这款 800 引脚的 AcceleRate® HP 高引脚数版本采用 8 行 × 100 列的引脚配置，同时兼顾了紧凑的封装尺寸和极低的外形高度：封装尺寸：68.62mm × 18.20mm（2.701 英寸 × 0.717 英寸）；外形高度：5mm 堆叠高度。800 引脚、堆叠高度为 10mm 的版本已纳入开发路线图，计划于 2026 年第二季度推出。

ADM6、ADF6 系列连接器还具备以下特性：92.5 欧姆阻抗、最大额定电流 1.2 安培（4 引脚供电）、最大额定电压 150 伏交流（212 伏直流），以及开放式引脚阵列设计，可实现最大化的接地与布线灵活性。

APM6 与 APF6 连接器以性能和可靠性为设计核心，采用 Samtec 焊柱板端接技术（产品型号中标注为“-0”）。随着互连器件日益小型化、微型化，焊点可靠性面临更大挑战，焊锡涂覆及工艺也成为信号完整性考量的重要部分。而焊柱端接技术可增强结构完整性，保障稳定的电气性能。

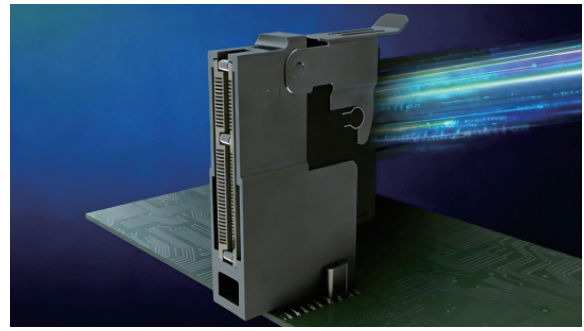
适用于超高密度、高速连接器；回流焊后形成柱状结构，结构完整性优异；高效分散热应力，可吸收形变；焊点符合 IPC 3 级标准；按 IPC-9701 标准完成焊点可靠性测试，测试温度范围为 -55℃ 至 125℃；电气性能出色。

（来源：矽泰连接器 /20260204）

安费诺推出 Cool Express Link

在人工智能、机器学习和高性能计算领域，强劲的数据处理能力至关重要。新一代存储标准 EDSFF（企业级和数据中心标准形式因子）正是为此而生，它已逐步取代传统固态硬盘，成为高性能计算场景的更优选择。

安费诺推出的 Cool Express Link，采用混合正交设计，符合 EDSFF E3 1C 和 DSFF E3 2C 标准，该设计支持垂直集成的 EDSFF 存储，实现高密度安装，从而提升系统设计效率。



Cool Express Link 还适配 CXL 3.1 应用。CXL（Compute Express Link）是一种开放标准互连技术，主要用于内存连接。

• Gen 5 和 Gen 6 高速信号传输：Cool Express Link 连接器支持 Gen 5 和 Gen 6 高速信号传输，适用于下一代服务器和存储应用。

• 正交式压铸外壳：采用坚固耐用的正交式压铸外壳，减少了对支撑连接器外部支架的依赖。

• 正交高密度设计：采用高密度设计，能够在前端面板容纳一组驱动器或设备。

• 压接连接器设计：压接式连接器设计，消除了表面贴装技术元件的高度限制

• 独立连接器和电缆组件：独立的连接器和线缆组件设计，降低了维护成本。

• 简易锁定和卡扣设计：简易锁定和卡扣设计，方便线缆开关。

混合设计能够有效地将电源和边带信号传送至中板，从而简化中板架构并降低成本。

支持将高速信号直接传输至主机端。满足人工智能、机器学习和高性能计算所必需的低延迟，低损耗要求。

（来源：安费诺信息通信 /20260224）

隆堡推出 25 系列 IPx7 防护等级 新型 RJ45 模块化穿墙馈通件

在工业连接领域持续创新的隆堡，凭借 25 系列的全新扩展，正稳步且系统性地丰富其 RJ45 网络穿墙馈通件的模块化连接器产品矩阵。此次，隆堡隆重推出 2543 系列，该系列包含四种精心设计的型号，专为应对严苛的工业环境而生。

这些防水面板安装插座符合 IPx7 防护等级要求，特别适用于控制柜、控制设备及生产系统等对可靠性

和密封性要求极高的应用场合。

新型号可满足各种应用需求。除了带焊接端子、适合手动焊接的模块化面板安装耦合器外，隆堡还可提供模块化双面板安装耦合器。根据型号不同，可提供塑料外壳（不带屏蔽）连接器或金属外壳（带屏蔽）连接器。带卡口锁机构的型号可实现快速安全的安装。



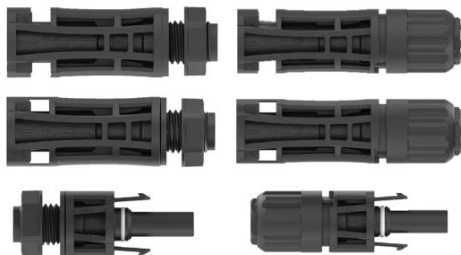
所有 2543 系列型号均基于成熟的 8p8c RJ45 接口，具备广泛的兼容性。其温度范围覆盖 -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$ 。同时，该系列产品机械强度高，插拔次数至少可达 500 次，经久耐用，为现代网络化工业应用提供了灵活且面向未来的解决方案，助力企业轻松应对未来工业发展的各种挑战。

（来源：隆堡 / 20260114）

TE Connectivity 推出全新 SOLARLOK PVA1 光伏连接器

在光伏产业迈向高质量发展的关键阶段，行业的焦点正从“规模与速度”转向“质量与价值”。连接器的可靠性决定系统长期表现的特点也愈发受到行业关注。为了提升光伏系统的电能传输与转换效率、降低单位发电的建设成本，行业正面临着更快速、更高效、更稳定的建设与运行挑战。相应地，系统设计也对设备与零部件提出了更紧凑、更便捷、更灵活的技术要求。

TE Connectivity 推出全新 SOLARLOK PVA1 光伏连接器。该产品适用于接线盒、组件端、线束及跳线连接，兼容自动化设备与现场安装，灵活应对各种应用场景。



全新 SOLARLOK PVA1 光伏连接器，专为 $2.5\text{--}6\text{ mm}^2$ 或 14-10 AWG 电缆设计，额定电压 1500 V，为光伏系统构建了安全耐用的连接基础。它延续了 SOLARLOK 系列标志性的可靠基因，并通过精细化设计与价值优化，为多种光伏应用场景，提供了更稳健、更具综合性价比的可靠选择。

核心优势：①可靠传承：全面延续 TE 产品一贯稳定可靠的品质，助力户外光伏系统持久稳定运行；②纤巧设计：造型紧凑，直径更小，轻松应对光伏板、逆变器等高密度布线场景，在狭窄空间中操作依然游刃有余；③灵活配置：支持设备固定或线缆连接等多种安装方式，可选不同的锁扣形式，简化现场安装、节约时间。

优化的核心电气性能：①额定电压：1500 V；②电缆范围： $2.5\text{--}6\text{ mm}^2$ / 14-10 AWG；③额定电流：高达 45 A；④防护等级：IP68，抗沙尘、暴雨、极端温差；⑤认证标准：IEC 62852 & UL 6703 & 2PFG 2925；⑥更低损耗，更高收益：接触电阻低至 $0.25\text{ m}\Omega$ ，能有效减少系统功率损耗，提升发电收益。

（来源：泰科电子 / 20260122）

I-PEX 推出 CABLINE®-UM 70pin 同轴线连接器



CABLINE®-UM 极细同轴线连接器再添重磅新品——70pin 高 Pin 数版本正式亮相。作为针对高密度、高速率互连需求的精准回应，该新品在延续系列产品核心优势的基础上，以更丰富的信号通道、卓越的传输性能和可靠的结构设计，为消费电子、工业控制、医疗设备、高端计算等领域的高端设备研发提供强大支撑，重新定义极细同轴线连接器的应用边界。

CABLINE®-UM 连接器采用 ZenShield® 全屏蔽设计，能够有效抵御外部电磁干扰 (EMI)，保障信号传输的

纯净度；多点接地结构进一步强化了屏蔽效果和电路稳定性，降低信号失真风险。

CABLIN®-UM 的有效嵌合长度 (≥ 0.65 毫米) 不仅大幅增加了端子与触点的接触面积，减少接触电阻以保障信号传输的连续性，更通过优化的接触压力分布设计，提升了连接器在长期使用过程中的抗磨损能力与环境适应性。搭配机械锁扣，确保连接器在插拔过程中定位精准、连接牢固，有效防止因振动、冲击等外力因素导致的接触不良，显著提升产品的使用寿命和环境适应性，满足工业级、医疗级等严苛应用环境的要求。

在传输性能方面，CABLIN®-UM 连接器支持 40 Gbps/ 通道的高速数据传输速率，且采用 PAM3 调制技术，能够在保证传输带宽的同时，有效降低信号衰减与干扰，确保高清视频、大容量数据、高速指令等信号的稳定传输。这一特性使其能够完美适配 5G 通信 8K 显示、高速存储等新一代技术应用场景，为高端设备的性能升级提供坚实保障。

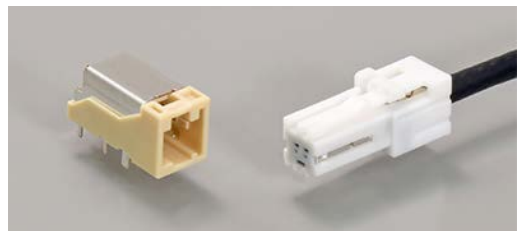
产品采用 0.4 毫米超细间距设计，在有限的安装空间内实现了更高的 Pin 数集成。此外，该产品采用 90 度出线直角插拔类型，不仅便于设备内部布线规划，减少空间占用，还能降低插拔操作对周边组件的影响，提升装配效率和维修便利性。

(来源：艾沛电子 /20260115)

JAE 推出支持千兆以太网的“MX74 系列”汽车用连接器

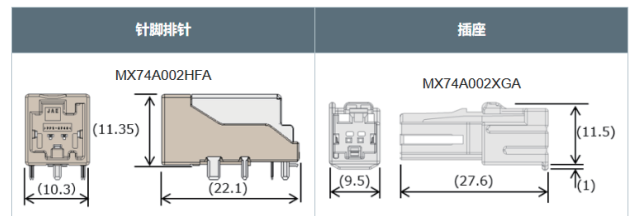
日本航空电子工业 (JAE) 关于车载以太网连接器 “MX74 系列”，在现有支持 100BASE-T1 车载以太网标准的产品基础上，新增支持 1000BASE-T1 标准 (可实现 1Gbps 通信速度) 的产品型号，并已正式对外销售。

近年来，汽车行业正基于 SDV (软件定义汽车) 这一全新理念推进汽车 E/E 架构 (电气 / 电子系统结构) 的开发。SDV 如同智能手机一样可以通过软件持续更新功能，有望依托联网服务提供多样化服务，因此强化连接通信模块的车载网络至关重要。此外在 ADAS (高级驾驶辅助系统) 领域，随着包括激光雷达在内的传感器性能的提高，传感器与 ECU (电子控制单元) 之间所需的通信速度也在不断提高。



在此背景下，本公司在车载以太网连接器 “MX74 系列” 产品线中新增了支持 1Gbps 通信速度的 1000BASE-T1 (* 1) 型号，并已正式对外销售。该产品采用小型低背设计，插头尺寸为宽 10.3mm × 高 11.35mm，插座尺寸为宽 9.5mm × 高 12.5mm，有助于实现汽车设备及零部件的高密度安装，满足汽车空间紧凑化的需求，其屏蔽性能符合开放联盟 (Open Alliance, * 2) 制定的《1000BASE-T1 链路段类型 A (STP) Ver 2.0 通道与组件要求》中规定的 Class 1 标准。

我们将继续满足日益复杂的车载网络对高速和大容量通信的需求：① 1000BASE-T1 (IEEE802.3bp)：通过单对双绞线实现高达 1Gbps 通信的标准。② 为统一车载以太网技术规格而成立的标准化组织。



产品特点：①支持 1000BASE-T1 车载以太网标准；②符合开放联盟 (OPEN Alliance) 的《1000BASE-T1 链路段类型 A (STP) Ver 2.0 通道与组件要求》中规定的 Class 1 标准；③采用小型低背设计：插头宽度 10.3mm、高度 11.35mm；插座宽度 9.5mm、高度 12.5mm；④支持 STP 电缆；⑤插座端作为单品连接器形式售卖。

一般规格：①针数：2 针；②额定电流：3A；③额定电压：30V；④绝缘电阻：大于等于 100M Ω (嵌合状态)；⑤耐电压：AC 1,000 Vr.m.s. (印加 1 分钟 嵌合状态)；⑥插拔力：小于等于 66.7N；⑦适用基板：1.2mm ~ 1.6mm；⑧适配电线：STP (AWG#26，电线直径 4.1mm)；⑨使用温度范围：-40 $^{\circ}\text{C}$ ~ +105 $^{\circ}\text{C}$ (已考虑通电后温升)

(来源：JAE 连接器 /20260204)

技术资讯

Molex 莫仕发布 2026 年十大预测

Molex 莫仕近日发布 2026 年十大预测，指出人工智能 (AI) 将在未来 12 至 18 个月内持续重塑所有主要行业领域，不仅会推动计算资源需求呈指数级增长，也会导致算力与连接领域出现重大瓶颈。在汽车、消费类电子、数据中心、工业自动化和医疗技术等高速增长领域，AI 驱动的数据激增与处理需求既为设计工程师创造了新机遇，也带来了新挑战。

Molex 莫仕高级副总裁兼数据通信和专业解决方案部门总裁 Aldo Lopez 表示：“无论是自动驾驶汽车传感器、高分辨率医疗成像，还是工厂实时控制系统，每个行业的 AI 模型都在产生海量数据，同时需要高速连接、先进电力传输及高效热管理技术提供支持。2026 年，我们将继续坚定不移地助力消除算力与连接的关键瓶颈，并与全球客户、供应商及合作伙伴共同开发面向未来、由 AI 驱动的基础设施。

2026 年十大预测：

1) 高速互连系统仍然至关重要，为现代超大规模数据中心的 AI/ 机器学习工作负载提供所需的速度和密度。

数据中心服务器或机箱内的主要计算元素（如 GPU 和 AI 加速器）之间的通信，需要组合方案：既包含为实现 224Gbps PAM-4 传输速度而设计的高速背板和板对板解决方案，又配备能支持高达 400/800Gbps 总速度，并为未来扩展至 1.6T 铺平道路的高速可插拔 I/O 连接器。

2) 能耗阻碍数据中心的扩展，因此推动了热管理的进步

扩展生成式 AI 应用，以及支持向 224Gbps PAM-4 过渡所需的高性能服务器和系统所产生的热量，远远超出了依赖风冷技术的传统解决方案的处理能力。在接下来的 12 至 18 个月，包括直接芯片液冷、浸没式冷却以及增强主动冷却的被动组件在内的液体冷却技术的发展，将持续获得关注与探索。

3) 共封装光学器件需求激增，支持“纵向扩展”架构

在 AI 驱动的架构中，共封装光学技术 (CPO) 被认为是处理 GPU-GPU 互连的关键。CPO 设计用于在芯片

边缘直接提供超高带宽密度，能在降低功耗与电信号损耗的同时，实现更高的互连密度。由于该技术专为应对超大规模数据中心及 AI/ML 集群的巨大功耗和带宽需求而开发，因此预计在未来一年，CPO 将备受关注。

4) 特种光纤为医疗技术领域的创新注入新动力

特种光纤能提供高精度连接，并具备抗电磁干扰 (EMI) 能力。光纤细如发丝，不仅日益广泛地为 MRI、CT 扫描仪等高分辨率成像设备提供支持，还为微创治疗提供集束激光能。此外，光纤还能有效解决卫星与空间系统的工程难题，可实现长距离海量数据传输，同时保持极低的信号衰减。

5) 坚固、可靠且小型化解决方案在各大行业领域势头渐盛

能够在严苛环境下稳定工作的紧凑、耐用型连接器，长期主导着汽车应用。如今，在超小外形尺寸下追求更高可靠性的技术边界业已拓展，渗透至消费类电子（如健身追踪器、智能手表和智能家居设备）、工业自动化（如仓储机器人、触摸屏和传感器）以及医疗器械（如内窥镜、胰岛素泵和可穿戴健康监测设备）等领域。

6) 电气化持续加速，催生对高速、大功率连接的强劲需求

作为下一代电动汽车区域架构的早期倡导者，Molex 莫仕实现了多种传感器、摄像头、雷达、LiDAR 及其他技术的互联互通，并特别注重开发能同时处理电源与高速信号的混合型连接器，以满足车内网络的需求。

7) 模块化解决方案和开放标准的需求在大多数行业领域日益增长

作为开放计算项目 (OCP) 的积极参与者，Molex 莫仕正致力于开发新一代数据中心冷却技术，及制定模块化硬件规范，以提升超大规模系统的性能、效率和模块化程度。通过与行业标准组织紧密协作，Molex 莫仕得以专注于缩小尺寸、减轻重量、降低功耗及控制成本 (SWaP-C)。

8) 48V 架构作为提升能效的通用标准获得广泛认可

48V 架构正在迅速成为 AI 驱动的数据中心和下一代汽车的通用电源效率标准。作为该电源架构的赋能

者，Molex 莫仕将推动 48V 技术创新，以解决汽车热密度难题并降低电缆重量，同时应对数据中心因生成式 AI 工作负载导致的电源尖峰问题，进而支持 OCP 开放机架第三版 (ORV3) 标准。

9) 得益于代理式 AI 的兴起，个性化继续演进

代理式 AI 能迅速适应不断变化的情况，为实时决策与个性化服务提供支持。在汽车领域，这将推动自动驾驶技术的进步与座舱内体验的升级，使它更接近于“第三生活空间”。在消费类电子与医疗技术可穿戴设备领域，更高的个性化程度可优化产品使用体验，而实时诊断功能则能改善健康福祉。在工厂车间，实时数据访问与自适应人机界面将提高生产力和运营效率。

10) 全球贸易波动加剧，对供应可选性和区域制造的需求日益增长

对 AI 驱动的数据生态系统进行投资，将推动数字化供应链智能发展，满足对新型区域供应网络和本地化制造的需求，从而应对不断变化的贸易政策。这一结果就要求，在对预测式采购智能化需求日益增长的背景下，必须提升供应链韧性。

(来源：线缆行业朋友分享圈 /20260131)

铝代铜：电气工程中的成本优化与轻量化革新之路

在电气工程领域，材料选择直接关系到项目成本、运行效率与长期可靠性。铜导体凭借优异的导电性能长期占据主导地位，但随着大规模电力传输、新能源产业及轻量化设计需求的崛起，铝导体以其独特优势逐渐成为铜的重要替代选项。然而，铝代铜在国内外的应用进程存在显著差异，其技术特性与实际应用中的挑战也值得深入探讨。

一、国内外铝导体应用的显著分野

铝导体的市场接受度在全球范围内呈现明显不均衡态势。在国内，低压配电系统中铝导体的应用比例尚不足 5%，传统电力配电与建筑布线场景中，铜导体依旧牢牢占据主导地位。不过这一格局正在逐步改变，在高压电缆、新能源、光伏电缆等新兴领域，铝导体的应用需求持续增长，年用量已达到约 220 万吨。

反观国际市场，美国、欧洲、印度等地区对铝导体的接纳度显著更高。在高压输电、电力线路及新能

源项目中，铝导体的应用比例普遍维持在 40%-80% 之间。其中印度电力市场的铝导体占比更是高达 80%，欧美高压电力线路中铝导体也成为主流选择，这种差异既源于技术理念的不同，也与各国产业政策、成本敏感度密切相关。

二、铝代铜的核心竞争优势

尽管铜的电导率远超铝，但在特定场景下，铝导体的综合优势依然不可替代，这也是其应用范围不断扩大的核心原因。

• **成本优势凸显：**金属市场的现货价格数据直观反映了两者的成本差距：铜的现货价格约为 97,000 - 98,000 元 / 吨（折合 98 元 / 公斤），而铝的现货价格仅约 20,000 元 / 吨（折合 20 元 / 公斤）。即便考虑到铝的电导率仅为铜的 61%，实际应用中需要适当增大截面积以弥补载流能力的不足，铝导体的材料成本仍仅为铜的 1/5 左右，在大规模电力传输等项目中具备极强的成本竞争力。

• **轻量化特性适配多元场景：**铝的密度仅为铜的一半，这一特性带来了一系列连锁优势：相同长度、截面积的铝导体重量更轻，不仅降低了运输过程中的物流成本，更大大简化了现场安装流程。同时，轻量化还降低了对支撑结构的载荷要求，尤其适用于高空架空线路、电动汽车、船舶等对重量控制极为严格的应用场景，为设备整体设计优化提供了更大空间。

• **抗腐蚀与高温适应性突出：**铝的表面能自然形成一层致密的氧化膜，这层保护膜使其在潮湿、盐雾等恶劣环境中展现出比裸铜更优异的抗腐蚀性能，延长了导体的使用寿命。此外，铝导体的电阻随温度升高的变化速率相对平缓，在一定温度范围内能保持稳定的导电性能，更适应高温工况下的可靠运行。

三、铝导体的基础特性解析

铝导体与铜导体的核心差异集中在导电性能上，而这一差异也决定了两者的应用边界。铝的电导率约为铜的 61%，这意味着在相同截面积下，铝导体的载流能力相对较低，因此在高电流需求场景中，必须通过增大截面积来弥补这一短板。

从材料性能综合表现来看，电导率与热导率是电气工程材料选择的关键指标。图 1 展示了不同金属材料电导率与热导率对比，铜合金以最优的性能组合

位居榜首，而铝合金紧随其后，凭借适中的电导率与较高的热导率，在需要散热的应用场景中表现突出。在大截面、轻量化的电力传输领域，铝合金的性能优势足以满足实际需求，应用价值显著。

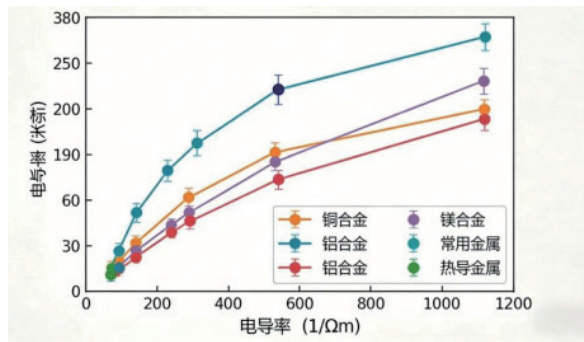


图1 不同金属材料电导率与热导率对比图

四、铝导体的主要应用场景

依托独特的性能优势，铝导体已在多个电气工程领域实现广泛应用，尤其在大截面、长距离传输场景中发挥重要作用：

- **高压电力传输：**作为铝导体最主要的应用场景之一，高压输电线路采用铝导体能够有效降低线路重量与建设成本，同时满足大规模电力远距离传送的需求，是全球电力网络建设的重要选择。

- **高压母线与变压器：**在高压母线系统中，铝导体的轻量化与成本优势得以充分体现；而采用铝合金绕组的变压器，不仅能显著降低设备整体重量，还能有效控制制造成本，提升产品市场竞争力。

- **电动汽车电池总线：**电动汽车对轻量化和抗腐蚀性的双重需求，与铝导体的特性高度契合。在电池系统中，铝导体既能保证稳定的导电性能，又能减轻车身重量，助力提升车辆续航能力。

- **特种电缆设计：**在高压电缆与各类特种电缆中，铝导体凭借优异的导电性能与散热特性，成为兼顾性能与成本的理想选择，广泛应用于新能源、工业控制等领域。

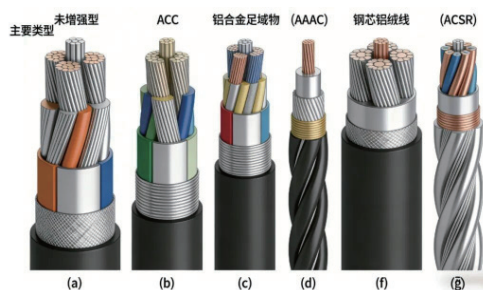


图2 铝基导体的主要类型示意图

五、铝导体性能的关键影响因素

铝导体的实际应用效果受多种因素制约，合理管控这些因素是确保其性能稳定的核心：

- **材料合金化工艺：**通过在铝中添加镁、硅等元素进行合金化处理，能够有效提升铝合金的机械强度，但同时会导致电导率略有下降。如何平衡强度与导电性能，成为铝合金配方设计的关键课题。

- **温升与散热管理：**由于铝的电阻高于铜，在相同电流条件下，铝导体的温升通常更为明显。若散热设计不当，过高的温度会加速导体老化甚至导致失效，因此在应用中必须重点关注散热方案的优化。

- **环境腐蚀影响：**湿度、腐蚀性气体等环境因素会加速铝导体的电偶腐蚀，尤其是当铝与铜等其他金属直接接触时，更容易形成腐蚀电池，加剧腐蚀进程。采用抗腐蚀性更强的铝合金材质、施加合适的表面涂层等方式，能有效提升其在恶劣环境中的耐用性。

- **机械应力与疲劳：**铝的机械强度相对较低，在高频振动、过载运行等工况下，容易发生疲劳性断裂或塑性变形（如电线拉长下垂）。因此在结构设计阶段，需要充分考虑机械应力的影响，预留足够的安全余量。

六、铝导体的失效模式与应对思路

了解铝导体的常见失效模式，是提升应用可靠性的前提：

- **电偶腐蚀：**潮湿或腐蚀性环境中，铝与其他金属接触形成的电偶腐蚀，是导致导体失效的重要原因。通过采用隔离措施避免异种金属直接接触、选用抗腐蚀涂层等方式，可有效减缓腐蚀进程。

- **热疲劳：**铝导体的温升较高，长期的热循环会导致导体疲劳，尤其当不同部件热膨胀系数不匹配时，界面处容易出现裂纹或剥离。优化散热设计、选用热稳定性更好的合金材料，能降低热疲劳风险。

- **机械疲劳与接触不良：**长期使用过程中，铝导体在接头、焊点等应力集中部位容易出现疲劳裂纹，进而导致接触不良。加强接头工艺质量控制、选用机械强度更优的合金导体，可提升连接部位的可靠性。

七、结语

轻量化、低成本、抗腐蚀性强的核心优势，让铝导体在电气工程领域的应用前景日益广阔。通过合金化改良、微观结构优化、散热与防腐设计升级等技术

手段，铝导体的电气性能与机械可靠性正不断提升，逐步弥补与铜导体的差距。

尽管在低压配电等传统场景中，铜导体仍占据主导，但随着新能源、高压输电、电动汽车等产业的快速发展，铝导体的应用场景将持续拓展。未来，只要

精准把控性能影响因素、有效规避失效风险，铝导体必将在成本优化与轻量化革新的浪潮中，成为电气工程材料选择的重要方向，为行业高质量发展注入新的动力。

（来源：线束世界 /20260129）

企业动态

安费诺 231 亿美元收官全年

安费诺集团 1 月公布了 2025 年第四季度及全年的创纪录财务报告。

2025 年全年：营收：全年达 231 亿美元，同比增长 52%，其中有机增长 38%，较 2024 年（152.23 亿美元）增长近 52%，较 2023 年（125.55 亿美元）近乎翻倍。盈利：调整后营业利润率 26.2%（历史新高），同比提升 4.5 个百分点；调整后每股收益（EPS）3.34 美元，同比激增 77%，盈利增速跑赢营收增速。订单与现金流：全年订单额 254 亿美元，同比增长 51%，订单出货比 1.1:1；经营现金流 5.4 亿美元，自由现金流 4.4 亿美元；全年向股东返还近 15 亿美元（股票回购+分红）。

2025 年 4 季度：Q4 营收：64.39 亿美元，同比增长 49%、环比增长 4%，有机同比增长 37%，创单季度历史新高且超指引上限。Q4 盈利：调整后营业利润率 27.5%，同比提升 5.1 个百分点、环比持平；调整后 EPS 0.97 美元，同比增长 76%，破单季度盈利纪录。Q4 订单：订单额 84.31 亿美元，同比增长 68%、环比增长 38%，订单出货比攀升至 1.31:1。

安费诺总裁兼首席执行官 R.·亚当·诺维特提到：“随着 2025 年的收官，我们很高兴地看到第四季度和全年的销售额以及调整稀释后每股收益均打破了记录，远超我们的预期。与去年同期相比，第四季度和全年的销售额分别增长 49% 和 52%，这主要得益于几乎所有终端市场的强劲有机增长，其中 IT 数据通信市场的表现尤为突出，公司的收购计划也带来了显著的贡献。在第四季度及全年，我们再次展现出卓越的盈利能力，调整后营业利润率分别达到 27.5% 和 26.2%。我们对公司在第四季度乃至整个 2025 年取得

的杰出业绩感到无比自豪！”

2026 第一季度展望：假设当前市场环境得以延续且汇率保持稳定，安费诺预计 2026 年第一季度的销售额将在 69 亿美元至 70 亿美元之间，较上年同期增长 43% 至 45%。调整稀释后每股收益预计在 0.91 美元至 0.93 美元之间，较 2025 年第一季度增长 44% 至 48%。该业绩预测已包含 CCS 业务带来的约 9 亿美元的销售额以及约 0.02 美元的调整稀释后每股收益。

（来源：节选，安费诺信息通讯、线缆行业朋友分享圈 /20260202）

莫仕 12 亿增资东莞，聚焦 AI 服务器高速连接

2026 年 1 月 29 日下午，东莞市副市长李辉与莫仕 Molex 高级副总裁 Aldo Lopez 一行面对面座谈，共同推进莫仕在东莞石碣进一步增资扩产，拟追加投资约 12 亿元，同时敲定落地投产节奏，探讨未来深化合作方向。重点聚焦 AI 服务器高速连接线生产，加速推进高端制造与智能化升级，持续巩固其在高速互连领域的技术与产业领先地位。

本次扩产将围绕 AI 算力基础设施快速增长带来的市场需求，提升高速互连产品在高频、高速及高可靠性方面的制造能力，推进线材加工、焊锡、注塑、测试等环节的自动化水平，同步开展线束线缆组装产品的设计与规模化生产工作，通过产线优化提升整体生产能力与运营效率。项目建成投产后，预计将实现产能结构与产品附加值的显著提升，为数据中心、AI 服务器等关键应用提供更具竞争力的互连解决方案。

（来源：莫仕连接器官微 /20260202）

瑞可达“机器人+全球化”双轮驱动

2026 年 1 月，连接器企业瑞可达（688800）在投资者调研活动中，系统介绍了其业务布局。公司作为国家专精特新“小巨人”，业务横跨新能源汽车、储能、通信、AI 数据中心及机器人等多个高增长领域。

在问答环节，投资者重点关注了公司在具身智能机器人领域的批量供货进展、高速铜缆产品量产在即的时间表、海外基地的产能与盈利状况，以及换电连接器的市场地位。公司展现出在多个前沿赛道均有产品落地的能力，并明确了全球化与新技术研发的战略方向。

调研现场主要观点：

1. 量产时间表明确：公司高速铜缆（AEC 等）400G/800G 产品预计在 2026 年第一季度开始批量交付，合资公司泰国生产基地也将同期开始海外生产交付。
2. 全球化布局加速：美国和墨西哥工厂已正式运营，其中美国工厂销售额与盈利持续增长；泰国与摩洛哥的生产基地正在建设或筹备中，并已在德国及美国硅谷增设销售办事处以拓展市场。
3. 机器人业务已成新增长点：公司与全球领先的多个具身智能机器人公司合作，已完成数十款产品开发并形成批量供货，该领域被列为公司未来重点发展方向之一。
4. 传统优势业务稳固：公司是国内最早开发并批量交付新能源汽车换电连接器的厂商，市场份额居国内前列，随着国家政策推动，该业务量正在不断增长。
5. 产品线持续拓展：液冷产品线已从新能源汽车和储能电池系统，拓展至数据中心领域（UQD 系列），为公司开辟了新的市场空间。

（来源：节选，行为金融明镜微信 /20260212）

富士达近期主导发布两项 IEC 国际标准，累计已达 18 项

近日，中航富士达科技股份有限公司在国际标准化领域再获重大突破——接连发布两项主导制定的 IEC 国际标准，这不仅代表了富士达的核心技术实力与标准引领能力获国际权威组织认可，更标志着中国企业在射频互连领域，正从技术追随者转变为全球规则的重要制定者。

率先发布的《射频同轴电缆组件 第 4-4 部分

频率达 6000MHz 接 50-5 型半硬同轴电缆多通道电缆组件详细规范》（IEC 60966-4-4:2025）是全球首个多通道射频同轴电缆组件国际标准，填补了该领域的国际规范空白，为 5G/6G 移动通信和雷达天线系统等高端无线设备提供了关键技术支撑。紧随其后发布的《多通道射频连接器第 4 部分 L32-4 和 L32-5 型圆形连接器分规范》（IEC 63138-4: 2026），广泛应用于大规模天线阵列及移动通信系统中。

IEC 60966-4-4:2025 规定的多通道电缆组件具有安装方便、损耗低、性能稳定和可靠性高等优点。IEC 63138-4:2026 是 IEC 63138 系列标准的重要组成部分，规定了 L32-4 和 L32-5 型圆形连接器的界面尺寸、额定值、质量评定程序等，是一种适用于多阵列天线及 RRU（如 TD-SCDMA 或 TD-LTE 系统中的智能天线与 RRU）的多同轴密封集束连接器。两项标准的发布为全球相关生产企业和用户在设计研发、生产制造、检验及应用方面提供了统一依据与指南，将有力促进行业产品一致性提升、工艺优化与整体技术水平进步，对推动我国相关产业国际化、增强国际竞争力具有重要意义。

凭借此次双标连发，富士达主导或参与制定、修订并成功发布的 IEC 国际标准总数已攀升至 18 项，彰显了富士达在国际标准化工作中的持续深耕与领先影响力。长期以来，富士达坚持“技术创新与标准引领”双轮驱动，积极投身标准制修订工作，不断巩固其在射频连接器及电缆组件领域的专业地位。此次两项标准的顺利发布，不仅进一步提升了中国企业在全球产业标准领域的话语权，更为我国相关产品开拓国际市场、深度融入全球供应链体系创造了有利条件。

（来源：中航富士达 /20260122）

立讯精密昆山成立新科技公司，入局无人机市场

近日，据企查查信息显示，立讯精密工业股份有限公司全资控股的艾界科技（昆山）有限公司正式成立，注册资本高达 4 亿元人民币。作为国内电子制造领域的龙头企业，立讯精密此次战略布局涵盖智能无人飞行器、可穿戴智能设备、智能车载设备等多个新兴智能硬件领域，被视为其智能制造产业链延伸的重要举措。

艾界科技的经营范围清晰地揭示了立讯精密的战

略方向：智能无人飞行器销售、可穿戴智能设备销售、智能车载设备销售、通讯设备销售等。这标志着立讯精密正在突破传统消费电子制造边界，向智能化、场景化的硬件生态加速渗透。

（来源：节选，线缆行业朋友分享圈 /20260124）

维峰电子实验室通过 CNAS 国家认可

2025 年 12 月 29 日，维峰电子（广东）股份有限公司正式获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。这标志着维峰电子自主建设的检测实验中心，其技术能力、管理水平与检测结果可靠性正式获得国家权威机构认可，达到了与国际接轨的实验室质量管理标准。

（来源：节选，维峰电子 /20260123）

中兴通讯发布《超节点技术白皮书》

近日，中兴通讯发布《超节点技术白皮书》，提出以超节点为核心打造标准化“AI 工厂”，通过系统级架构创新，突破算力极限与能效瓶颈，为 AI 基础设施的可持续发展提供新路径。

- 突破通信瓶颈：超节点实现高效协同计算

随着 AI 模型参数规模突破万亿量级，算力需求正在从单芯片堆叠向系统级协同转型，传统分布式训练面临通信开销剧增和算力利用率下降等挑战。为解决这一问题，超节点采用高速互联协议和专用交换芯片，构建高带宽域（HBD），将数十到数百颗 GPU 芯片逻辑整合为统一编址、低延迟、高带宽的协同计算系统。

这一架构在保留 GPU 物理独立性的同时，带来了类单机的编程与调度体验，显著提升了算力利用效率，为大规模模型训练和推理提供了高性能的算力底座。

- 架构创新：OEX 正交无背板互联，零线缆

在硬件层面，白皮书重点阐述了中兴通讯自研的 OEX（Orthogonal Electrical eXchange）正交无背板互联交换架构。该架构通过物理设计的根本性创新，具体呈现高密集成、高可靠、简化运维、开放互联四大核心亮点。

- AI 工厂模式：打造标准化的智能生产流水线

针对 AI 落地复杂度高、交付周期长的痛点，白皮书倡导从“项目制”向“工厂模式”转型，将 AI

能力建设升级为标准化的现代化流水线：软件栈即操作系统；集群弹性扩展。

- 全栈协同：打造开放共享的智算生态

白皮书强调，构建 AI 工厂是一项涉及芯片、整机、网络与软件的复杂系统工程。中兴通讯凭借 40 多年通信领域的系统工程积累，已构建起从自研系列高性能芯片、复杂系统设计到全球工程交付的全栈能力体系。

展望未来，中兴通讯将坚持开源开放理念，携手产业伙伴推动智能算力基础设施的标准化与生态化，共同构建高效、绿色、可持续的 AI 发展体系。

（来源：节选，讯石光通讯 /20260210）

泰科与汇川技术签署战略合作协议

1 月 26 日，TE Connectivity（以下简称“TE”）与汇川技术，在汇川技术苏州总部正式签署战略合作协议。此次合作旨在深化双方在工业自动化领域的协同发展，通过优势互补与资源整合，实现双向赋能，共同推动智能制造生态体系建设。

以技术创新为纽带，此次战略合作将重点聚焦三大核心方向：

- 深化技术协同创新，共建数智发展新动能：双方将建立常态化技术协同机制，整合优势资源，联合打造 OT/IT 融合智能解决方案，重点探索产线预测性维护、推动工厂数智转型、加快 AI 工业场景落地，赋能生产管控，提升核心技术竞争力与市场影响力。

- 深耕本土应用场景，践行“研发在中国、服务为中国”理念：立足本土制造需求，双方将构建本土化研发、服务、适配体系，精准对接企业个性化需求，强化本土服务团队建设，助力本土制造企业转型升级，彰显服务本土、赋能实业的责任担当。

- 携手开拓国际市场，构建协同出海新模式：依托 TE 全球网络、国际运营经验及认证优势，结合汇川技术自动化产品实力，汇川技术与 TE 将搭建协同出海平台，精准对接全球市场需求与标准，优化推广策略，共拓国际市场，推动自动化产品规模化出海，提升中国自动化产品国际影响力，实现双方互利共赢。

（来源：泰科电子 /20260126）

专利信息

国家知识产权局专利公开公告情况（2025 年 1-12 月、2026 年 1 月）

现对国家知识产权局公开的 2025 年 1-12 月、2026 年 1 月的连接器专利情况及分会关注的 6 家开关厂家的专利情况进行统计公示。其中连接器前 10 名厂家的专利数据情况请见图 1-4，开关企业的专利数据情况见 5-6。

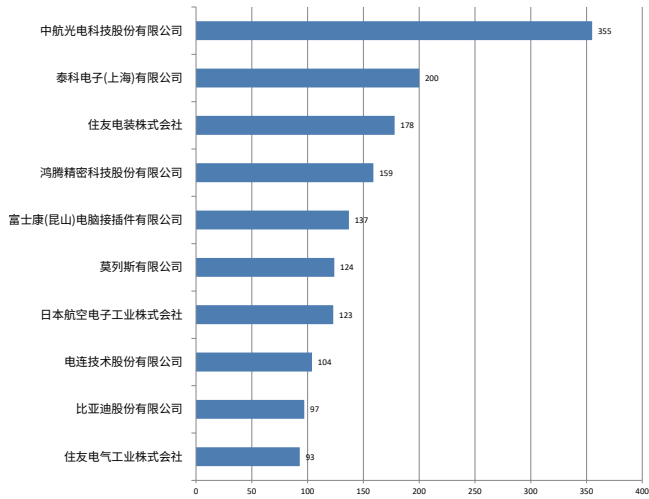


图 1 2025 年 1-12 月申请人前十位专利量排行情况（连接器）

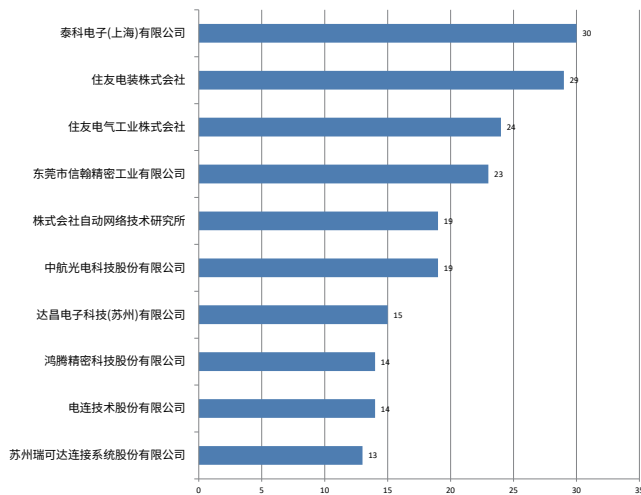


图 3 2026 年 1 月申请人前十位专利量排行情况（连接器）

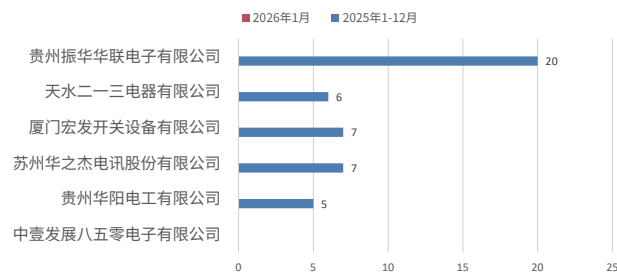


图 5 2025 年 1-12 月关注厂商专利排名（开关）

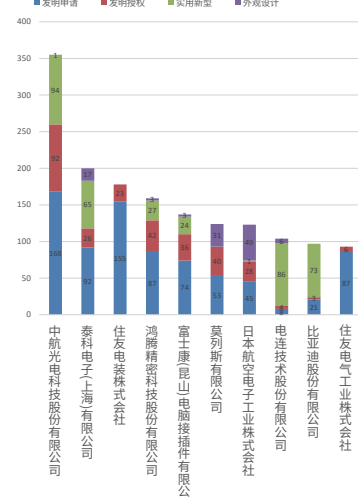


图 2 2025 年 1-12 月部分厂商公开专利情况（连接器）

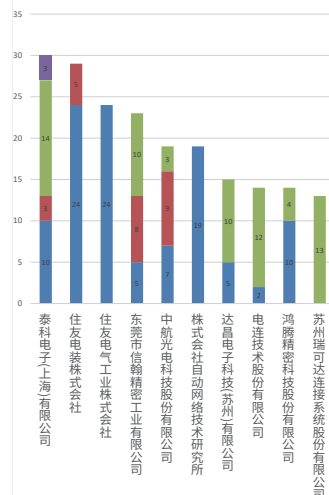


图 4 2026 年 1 月部分厂商公开专利情况（连接器）

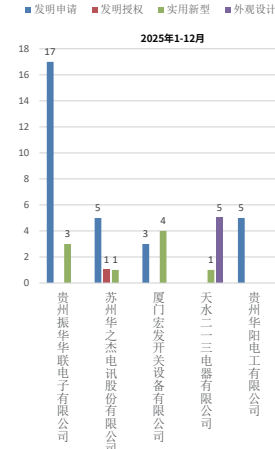


图 6 2025 年 1-12 月关注厂商公开专利情况（开关）

注：2026 年 1 月关注的各开关企业无公开专利信息。

协会公告

分会 2026 年近期重点发布讯息

1、将正式发布《中国电子元件电接插件元件行业“十五五”发展规划（2026-2030）》，并印制纸质版发放至分会全体会员单位（已缴纳 2025 年会费的会员）；

2、将正式发布 2025 年编制的《JHD 系列商业卫星用 56Gbps 矩形高速 I/O 连接器》、《MLRM 系列商业卫星用 25Gbps 矩形高速模块化连接器》、《轨道交通设备用 TJ22 系列推拉矩形连接器》、《数据通信用 ASM 系列矩形连接器》、《数据中心用 GF9A 系列 224Gbps 矩形高速电缆组件》五项团体标准，纸质版标准依据中国电子元件行业协会总会印制计划发放至全体参编单位，需要标准的会员单位，可单独联系分会秘书处获取。

分会组织的多项团体标准会议在武汉顺利召开

2026 年 2 月 5-7 日，中国电子元件行业协会电接插件元件分会组织的团体标准《数据中心用 GF9A 系列 224Gbps 矩形高速电缆组件》技术审查会，新立项的《刚挠板连接组件通用技术要求》、《非接触电传输连接组件通用技术要求》、《防雷连接器通用技术要求》、《核电脉冲连接器通用技术要求》、《电动垂直起降飞行器用高压电连接器通用技术要求》、《电动垂直起降飞行器 EWIS 电缆组件通用技术要求》、《YSG06 系列深水密封电连接器》、《服务器用 HJ003 系列矩形电源连接器》等八项团体标准草案讨论会和 T/CECA 61-2021《1.0mm、1.27mm、2.0mm、2.54mm 间距印制板用两件式连接器》、T/CECA 62-2021《轨道交通用 GTCM 系列高可靠圆形光电混装连接器》、T/CECA 63-2021《轨道交通用牵引电机圆形电连接器》和 T/CECA 65-2021《BPMP 系列射频同轴连接器》等四项标准复审会议在湖北武汉顺利召开。

本次会议特邀了中国电子元件行业协会、行业用户单位及行业企业专家共计 38 家单位 75 位代表参加会议。



会议伊始，中国电子元件行业协会标准管理部主任肯定了分会在团体标准工作上的成绩，特别强调了推动团体标准应用实施的重要性，以及对于新增的试验验证要求，各牵头单位应提前谋划，确保各阶段工作按计划有效推进。

2 月 5-6 日，会议主要围绕标准技术审查、草案讨论开展。与会期间，专家们认真听取了标准编制组就标准编制过程简介、编制原则、主要技术内容说明、征求意见及其汇总处理情况等汇报，以科学求实、认真负责的态度，逐章逐条对《数据中心用 GF9A 系列 224Gbps 矩形高速电缆组件》送审稿和《刚挠板连接组件通用技术要求》等八项标准草案进行了审查和讨论，均提出了修改意见和建议。经审议，审查专家组一致认为，团标《数据中心用 GF9A 系列 224Gbps 矩形高速电缆组件》填补了国家标准和行业标准在相关连接器领域标准的空白，同意该项标准送审稿通过审查。后续，八项标准草案将依据评审问题清单，修改完善标准内容。

2 月 7 日上午，会议主要围绕标准复审开展。牵头单位逐项进行汇报，与会专家从标准概况、标准技术要求及适宜性、与相关标准的协调性、标准涉及产品类型的适应性、标准及产品的市场应用情况及前景等方面对 4 项团体标准进行了评议审查，经充分讨论，专家组一致认为该四项标准的复审结论均为“修订”。

通过本次会议，紧密对接行业用户需求，统筹产品技术创新与市场应用的标准化要求，为提高团体标准编制质量、增强标准的实用性与适用性、推动电接插件元件行业标准更好服务产业发展奠定基础。

GB/T 1.1、GB/T 20001.10 标准 专题培训顺利完成

为持续有效开展电接插行业相关培训工作，更好服务会员企业，提供相关知识支撑与帮助，进一步加强分会各成员单位对行业相关共性知识的掌握，中国电子元件行业协会电接插元件分会于 2026 年 1 月 17 日，通过线上会议的形式，组织开展了一期标准专题培训。

本次培训特邀中国电子技术标准化研究院标准化专家乔虹老师授课，乔老师主要结合 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T2001.10—2014《标准编写规则 第 10 部分：产品标准》，重点从标准编写的依据和规则，两个标准内容的解读，以及标准编写中常见问题的解析四个方面进行了详细讲解。

通过本次培训，帮助广大会员单位中承担国家标准、团体标准编制的产品研发人员、产品标准化人员及相关管理人员系统性地掌握标准编写的依据、结构规范与起草规则，为后续在标准编制过程中有效提升标准文本的规范性、逻辑性和可操作性，提供技术支撑。

如有需要培训资料的会员单位，可通过“中国电子元件行业协会电接插元件分会”官网，登录会员账户后，从“行业书刊”板块查阅。

若无会员账号，请自行使用各自的公司邮箱注册，或用户名使用公司名简拼，否则后台无法识别是否为会员单位，将影响账号使用。

2026 年中国电子元件行业协会秘书长 联席会议在哈尔滨召开

2026 年 1 月 9 日，2026 年中国电子元件行业协会秘书长联席会议在哈尔滨召开。本次会议由中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会承办。中国电子元件行业协会常务副理事长古群，党支部书记、秘书长黄森，副秘书长李锋，中国电子元件行业协会十五个分会的秘书长及中国电子元件行业协会秘书处工作人员，共 42 人参加了本次会议。中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会理事长单位——中国电子科技集团公司第四十九研究所党委书记周均忠出席会议并致欢迎辞。会议由黄森秘书长主持。

会议伊始，古群常务副理事长对协会 2025 年工作进行全面总结，具体介绍了协会党建工作，协会组织建设，向会员提供服务，承担政府部门交办工作，行业信用等级评价，标准化建设，参与反倾销、反垄断工作，《中国电子元器件行业“十五五”发展规划》编制工作、“2025 年中国电子元件骨干企业”发布、协会活动，乡村振兴工作及捐款捐物、走访会员单位等多个方面的工作情况，并介绍 2026 年工作要点。古群常务副理事长指出，2025 年，协会在党建引领下，各项工作取得显著进展，为行业发展提供了有力支撑。2026 年，要继续提升协会管理水平，充分发挥桥梁纽带作用，推动电子元器件行业高质量发展。

随后，各分会秘书长依次就各自分会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划做了汇报，总结经验、分析不足，并对 2025 年电子元器件行业各分支领域整体发展情况进行了总结。

之后，黄森秘书长就社会团体内部治理相关要求做了专题说明，强调协会应注意名称规范、财务管理、合规收费等关键事项，并详细介绍协会了 2026 年的重点工作安排。

会议当天下午，与会人员就协会财务管理、团体标准政策宣贯等相关工作事宜进行了讨论。

最后，会议对中国电子元件行业协会各分会就会员发展、会员服务、分会活动等多项考核指标进行了综合评定。最终，**电接插元件分会**、电容器分会、光电线电缆及光器件分会、电感器与变压器分会和敏感元器件与传感器分会被评选为“2025 年度中国电子元件行业协会先进分会”。



此次会议的召开，为中国电子元件行业协会 2026 年的工作指明了方向。新的一年，协会将继续坚持党建引领，凝聚行业力量，引导企业积极应对国内外市场挑战，携手攻克技术难题，共同推动中国电子元器件行业迈向新的高度。

中国电子元件行业协会收到工业和信息化部运行监测协调局的感谢信

2025 年 12 月 30 日，中国电子元件行业协会秘书处收到工业和信息化部运行监测协调局的感谢信，对协会在 2025 年为工业和信息化部运行监测协调局开展的电子信息制造业运作分析工作表示诚挚的感谢，并对协会常务理事古群、副秘书长李锋等同志的积极贡献给予高度认可。

中国电子元件行业协会，作为电子元件行业的全国性社会组织，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，恪守为政府、行业发展、会员单位服务的根本宗旨，积极发挥政企间的“桥梁”与“纽带”的作用，为政府科学决策提供有力支撑，持续助力我国电子元器件产业实现健康、快速、可持续发展。

2025 年，中国电子元件行业协会在扎实完成对工业和信息化部运行监测协调局的支撑服务工作的同时，也积极向工信部电子信息司、规划司、商务部对外贸易司、国家发展和改革委员会创新和高新技术发展司以及国家市场监督管理总局反垄断局等政府部门建言献策，精准反映行业动态与企业诉求，为完善产业政策、优化发展环境贡献了专业力量。

2026 年，中国电子元件行业协会将继续全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握高质量发展这一首要任务，紧密围绕国家宏观战略部署，积极配合工业和信息化部等相关部门。面对新形势、新任务，协会将坚守初心、发挥优势、攻坚克难，持续提升自身在服务企业、服务行业、服务政府、服务社会的能力，为维护产业链安全稳定，推动产业高端化、智能化、绿色化转型，加快建设现代化产业体系作出更大贡献！

关于持续向广大会员单位征集稿件的事宜

各会员单位：

“简报”是分会持续开展行业内交流的窗口和平

台，为提升分会服务能力，向会员单位提供更多行业信息。同时，通过该平台向上下游客户处推广企业新技术、新产品，提高各会员单位在行业的影响力。分会拟持续对《电接插元件信息简报》的文章来源进行优化改进。向全体会员单位长期征稿，具体需求如下：

一、稿件范围

行业市场发展动态解析；新产品、新技术介绍；技术研究类论文；行业相关标准化知识及信息；行业相关产品专利分析。

二、稿件要求及激励

1、各会员单位可不定期提供稿件，分会每两个月结合投稿情况，进行刊登；

2、所投稿件需为原创信息；

3、对提供并刊登稿件的分会成员单位设立稿费奖励：

①新产品、新技术介绍的稿件，字数应在 500 字左右，且需提供至少一张产品配图（三维立体图 / 平面图，图片格式），每篇 100 元；

②其他类稿件，600 字 < 字数 < 2000 字，每篇 200~300 元；字数 ≥ 2000 字，每篇 300~500 元。希望各会员单位在百忙之中能够结合各单位的优势，参与行业技术分享和推进工作！

联系人：郭钰文（分会秘书）13623885978

邮箱：mishuchu158@jonhon.cn

说明：

①本征稿通知长期有效；

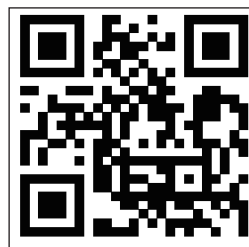
②在收到稿件后 1 周内会通过邮件告知是否采稿；

③稿费将在采稿简报当期出刊后 1 个月内转账至投稿人处。

④为确保联系畅通，请随时关注投稿邮箱信息。



分会微信订阅号



分会官网

扫描二维码并关注，及时获取更多中国电子元件行业协会电接插元件分会及行业资讯！



中国电子元件行业协会
电接插元件分会

ASSOCIATION POLICY 工作方针

交流合作 聚力共享 合规自律 开放引领

ABOUT 关于协会

电接插元件分会于一九八六年十一月六日成立，隶属于中国电子元件行业协会。分会主要由从事电接插元件、开关与组件及其相关的零部件、材料、制造、科研等企（事）业单位和个人资源组成的，不受地区、部门和所有制限制，不从事营利性经营活动的全国性行业组织。分会现有会员单位共 160 余家。



分会官网



分会公众号



申请入会



中国电子元件行业协会电接插元件分会

Electrical Connectors Branch of China Electronic Components Association

地址：河南省洛阳市涧西区浅井南路与丽春西路交叉口

邮编：471003

电话：0379-63011334

邮箱：connector@ic-ceca.org.cn

网址：connector.ic-ceca.org.cn